

L'ingegneria software irpina vola in Germania

27-11-2008 *AAPS Informatica debutta nel mercato internazionale dell'ingegneria software. Dal 3 al 6 dicembre l'azienda irpina sarà presente a Francoforte, in Germania, ad Euromold 2008. Una delle più prestigiose fiere al mondo per la fabbricazione di stampi, strumenti, disegno e sviluppo delle applicazioni. Previsti oltre 1600 espositori e più di 60 mila visitatori.*

AAPS Informatica ambasciatrice campana ad Euromold 2008. La fiera, in programma dal 3 al 6 dicembre a Francoforte in Germania, è una delle più importanti vetrine mondiali per la fabbricazione di stampi, strumenti, disegno e sviluppo delle applicazioni. L'evento riunirà, presso l'Exhibition Centre della città tedesca, ingegneri industriali, sviluppatori di prodotti, produttori, fornitori ed utenti finali per presentare i metodi più dinamici, economici ed efficienti per lo sviluppo e la produzione dei nuovi prodotti. Previsti più di 1.600 espositori ed oltre 60mila visitatori. Dalla progettazione alla prototipizzazione, alla produzione di grandi serie: Euromold presenta l'intera catena del processo. In questo palcoscenico di tutto rilievo AAPS, azienda con sede madre ad Avellino e filiali a Roma e Monza operante da oltre quattordici anni nel settore dell'Information & Communication Technology, rappresenterà l'ingegneria software regionale legata alla progettazione industriale.

Giovedì 4 dicembre presenterà il suo software "Go-Mesh", prodotto che velocizza, mediante l'apporto di tecnologie innovative, la capacità di progettazione industriale, in un forum internazionale sulla simulazione numerica, illustrando un'importante innovazione nel campo della telefonia cellulare realizzata per una nota multinazionale operante nel settore delle telecomunicazioni. Verranno spiegate le caratteristiche ed evidenziati i benefits derivanti dall'avanzata tecnologia messa in piedi da "Go-Mesh". Preso come caso studio il display di un nuovo telefono cellulare. In sostanza, lo scopo sarà quello di utilizzare il software irpino al fine di analizzare diverse configurazioni del display, cercando di ridurre il rischio di rottura dei componenti elettronici durante un'eventuale caduta del telefono cellulare. Già oggetto, nel mercato italiano dell'aeronautica, di un recente accordo commerciale con una nota società di ingegneria per la progettazione di parti meccaniche di aeroplani, il prodotto si appresta adesso a fare il suo debutto nel mercato mondiale. Nato dalla collaborazione con importanti organismi di ricerca universitaria, esso si rivolge alle aziende italiane e non che operano in diversi settori industriali quali automotive, aerospazio, elettronica di consumo, navale, energia.